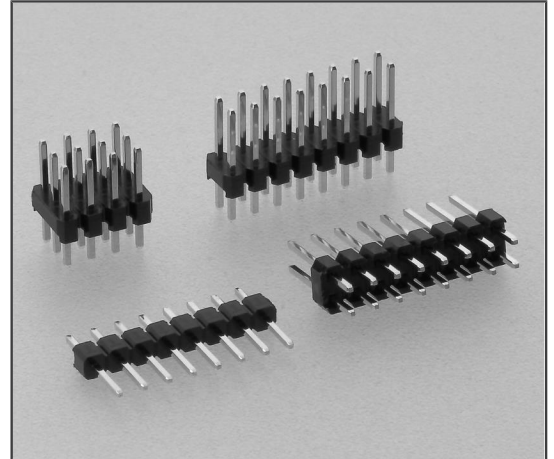


TC-18863 / TC-18884 / TC-18905

Stiftleisten RM 2,54mm, gerade, 1-/2-/3-reihig *Pin Headers, 2.54mm Pitch, Straight, 1/2/3 Rows*

Technische Daten / Technical Data

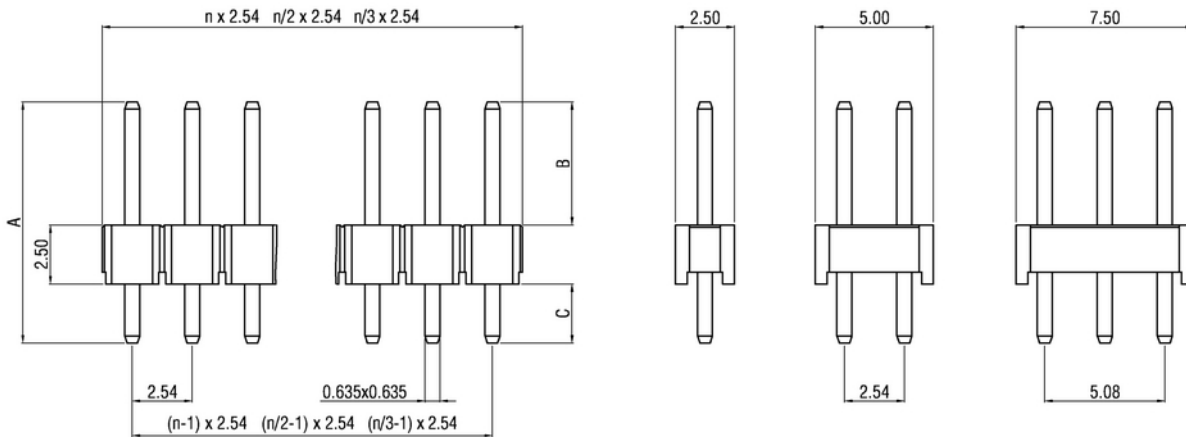
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>< 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV _{DC} <i>1kV_{DC}</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250V _{AC} <i>250V_{AC}</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A <i>3A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +125°C <i>-40°C ... +125°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



Passende Buchsenleisten

Compatible Female Headers:

TC -0306 / TC -0308 / TC -0314157 etc .
Weitere siehe Kapitel B *Please see ch. B for*



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12
Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.

Series *

TC-18884

Gestanzte/geprägte Kontakte
Stamped/formed contacts

TC-18863 Einreihig
Single row

TC-18884 Zweireihig
Double row

TC-18905 Dreireihig
Triple row

Dimensions *

10

10 A=10,20 B=5,20 C=2,50mm
11 A=10,80 B=5,80 C=2,50mm
12 A=11,30 B=5,50 C=3,30mm
13 A=12,60 B=6,80 C=3,30mm
14 A=13,90 B=8,10 C=3,30mm
15 A=14,70 B=8,90 C=3,30mm
16 A=17,70 B=11,90 C=3,30mm
17 A=19,80 B=14,00 C=3,30mm
18 A=21,60 B=15,80 C=3,30mm
19 A=22,80 B=17,00 C=3,30mm
20 A=24,90 B=19,10 C=3,30mm
A [mm] Kundenspezifisch (max. 72,5mm)
Customer-specific (max. 72,5mm)

Contacts *

010

001-050 Einreihig
Single row
004-100 Zweireihig
Double row
009-120 Dreireihig
Triple row

Plating *

00

00 Vergoldet
Gold plated
110 Sel. Au 0,25µm / flash
130 Sel. Au 0,75µm / flash
50 Verzinkt
Tin plated
66 Sel. Au / Sn
610 Sel. Au 0,25µm / Sn
80 Sel. Au 0,75µm / Sn
Au flash = min. 0,025µm

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl.
 Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie
 weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage.
 Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter
 Techn. Informationen.

We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches as well as more dimensions on request. Order page "Customer-specific Pin Configurations" in Technical Information.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** -
 please replace by your specifications.

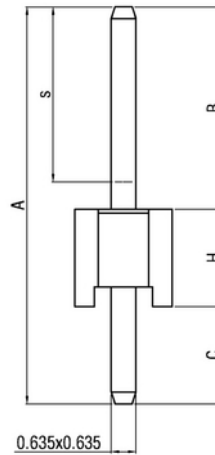
Stiftleistenmaße und PCB Layouts für 0,635mm Vierkantstifte

Dimensions and PCB Layouts

Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

- A : Gesamstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

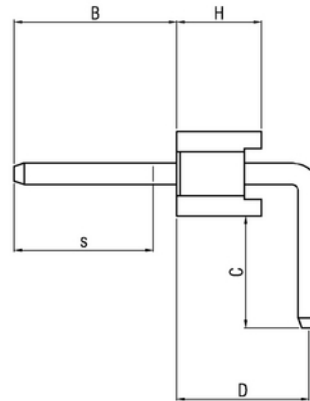
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



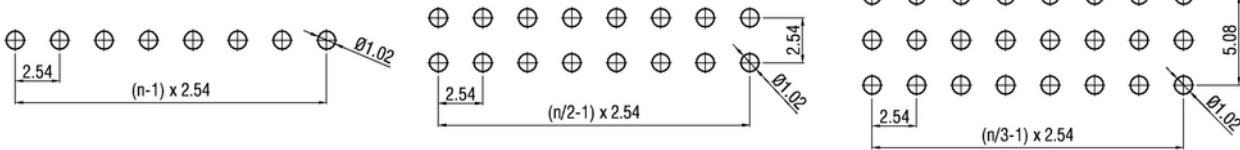
Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



PCB Layouts

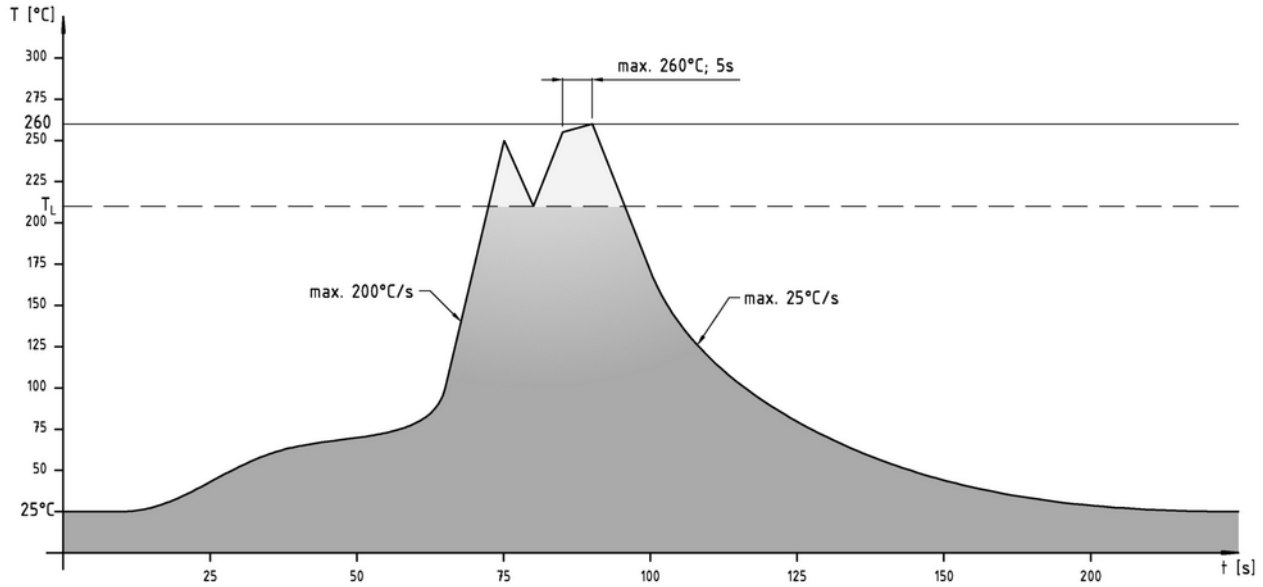


Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

